

无锡泰连芯科技有限公司

TLX8651

精密、零漂移、轨到轨输出、高压（32V）
运算放大器

2024 年 06 月

精密、零漂移、轨到轨输出、高压（32V）运算放大器

1 特性

- 单位增益带宽: **2.0MHz**
- 输入失调电压最大值: **50 μ V**
- 输入失调电压温漂: **$\pm 0.1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$**
- 低输入噪声: **0.6 μVpp (0.1Hz ~ 10Hz)**
- 低静态电流典型值: **900 μA**
- 轨到轨输出
- 优异的直流精度:
 - 电源抑制比: **130dB**
 - 共模抑制比: **120dB**
 - 开环电压增益: **130dB**
- 单电源工作电压范围: **3.3V ~ 32V**
- 双电源工作电压范围: **$\pm 1.65\text{V} \sim \pm 16\text{V}$**
- 最高工作温度: **+85 $^\circ\text{C}$**
- 封装: **SOP8**

2 应用

- 温度测量
- 半导体测试
- 压力传感器
- 医疗设备
- 测试设备
- 模数转换驱动
- 精密电流检测

3 概述

TLX8651 CMOS 运算放大器采用自归零 (Auto-Zero) 技术, 可同时实现极低失调电压 (最大值 50 μV) 以及近乎为零的时漂与温漂。该放大器兼具超低噪声、失调和功耗特性。

这款微型高精度运算放大器兼具高输入阻抗与轨到轨输出摆幅, 其增益带宽积为 2.0MHz, 压摆率达 1.0V/ μs , 支持单电源 (3.3V 至 32V) 或双电源 ($\pm 1.65\text{V}$ 至 $\pm 16\text{V}$) 供电。

TLX8651 运算放大器的工作温度范围为 -40°C 至 $+85^\circ\text{C}$ 。

器件信息 ⁽¹⁾

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX8651	SOP8	4.90mm x 3.90mm

(1) 详细的订单型号说明, 请参考数据表后的封装选项部分。

目 录

1 特性 2

2 应用 2

3 概述 2

4 修订历史 4

5 封装和订单说明⁽¹⁾ 5

6 引脚定义和功能（顶视图） 6

7 规格 7

 7.1 绝对最大额定参数 7

 7.2 ESD 等级 7

 7.3 推荐工作条件 8

 7.4 典型电气参数 9

 7.5 典型参数曲线 11

8 封装规格尺寸 14

9 包装规格尺寸 15

4 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.1	2022/09/13	正式版, 版本升级
A.2	2023/05/22	在 A. 1 版本第 7 页更新 V_{OS} 参数
A.2.1	2024/03/01	修改包装命名
A.3	2024/06/24	1. 在 A.2.1 版本第 4 页添加 MSL 2. 增加图 13. 开环增益和相位裕度与频率的关系 3. 更新封装备注

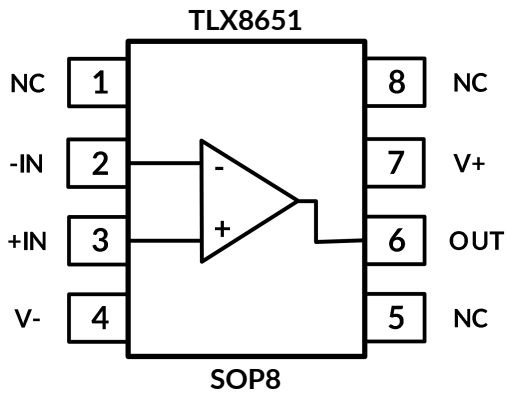
5 封装和订单说明⁽¹⁾

订单型号	封装类型	工作温度(°C)	MSL ⁽³⁾	质量等级
TLX8651XK	SOP8	-40°C ~85°C	MSL3	工业级

注意:

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) TLXIC 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 技术支持联系。

6 引脚定义和功能（顶视图）



引脚功能

引脚名称	引脚	I/O ⁽¹⁾	功能说明
	SOP8		
NC ⁽²⁾	1,5,8	-	无内部连接（可以悬空）
-IN	2	I	反相输入脚
+IN	3	I	同相输入脚
V-	4	-	负电源（或者低电压）供电脚
OUT	6	O	输出脚
V+	7	-	正电源（或者高电压）供电脚

(1) I=输入管脚, O=输出管脚。

(2) 表示没有内部连接。通常，GND推荐与散热平面连接。

7 规格

7.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
电压参数	工作电压, $V_S = (V_+) - (V_-)$	双电源供电		±18	V
		单电源供电		36	
	输入引脚 ⁽²⁾	共模电压	(V ₋)-0.5	(V ₊)+0.5	
		差分电压		±0.7	
	输出引脚 ⁽³⁾		(V ₋)-0.5	(V ₊)+0.5	
电流参数	输入引脚 ⁽²⁾		-10	10	mA
	输出引脚 ⁽³⁾		-50	50	mA
	输出短路电流 ⁽⁴⁾		持续		
θ_{JA}	结至环境热阻 ⁽⁵⁾	SOP8		110	°C/W
温度参数	自然通风条件下的工作温度范围, T_A		-40	85	°C
	结温, T_J ⁽⁶⁾		-40	150	
	储存温度范围, T_{stg}		-65	150	

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 输入端口内部设计有对电源轨的钳位保护二极管，当输入信号超过电源轨 0.5V 及以上时，必须限制输入电流不超过 ±10mA。
- (3) 输出端口内部设计有对电源轨的钳位保护二极管，当输出信号超过电源轨 0.5V 及以上时，必须限制输出电流不超过 ±50mA。
- (4) 输出对地短路时会导致过热并对芯片造成永久损坏，故无法测试极限值。
- (5) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。
- (6) 最大功耗是有关 T_J (MAX)、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_J(MAX) - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

7.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

			标称值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范 ⁽¹⁾	±2000	V
		带电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 规范 ⁽²⁾	±1500	
		机械模型 (MM)	±500	

(1) JEDEC 文件 JEP155 指出，500V HBM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。

(2) JEDEC 文件 JEP157 指出，250V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

7.3 推荐工作条件

在自然通风温度范围内（除非特别注明）

		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压范围， $V_s = (V+) - (V-)$	单电源供电	3.3		32	V
	双电源供电	± 1.65		± 16	

7.4 典型电气参数

测试条件为: $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 3.3\text{V} \sim 32\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, 全温⁽⁹⁾ = $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ (除非特别说明)⁽¹⁾

参数		测试条件	T _J	TLX8651			单位
				最小值 ⁽²⁾	典型值 ⁽³⁾	最大值 ⁽²⁾	
供电参数							
V _S	工作电压范围		25°C	3.3		32	V
I _Q	静态工作电流	V _S =±2.5V, I _o =0mA	25°C		0.9	1.25	mA
			全温			1.5	
		V _S =±16V, I _o =0mA	25°C		1.1	2.0	
			全温			2.5	
PSRR	电源抑制比	V _S =5V to 32V	25°C	110	130		dB
			全温	100			
输入参数							
V _{OS}	输入失调电压	V _{CM} = V _S /2	25°C	-50	±3	50	μV
			全温		±15		
V _{OS} T _C	输入失调电压温漂	V _{CM} = V _S /2	全温		±0.1		μV/°C
I _B	输入偏置电流 ^{(4) (5)}	V _{CM} =0V	25°C		100	1000	pA
			全温		600		
I _{OS}	输入失调电流 ⁽⁴⁾	V _{CM} =0V	25°C		100		pA
			全温		600		
V _{CM}	共模输入电压范围	V _S = ±16V	25°C	(V-)		(V+)-1.5	V
CMRR	共模抑制比	V _S = ±16V V _{CM} =(V-)+0.3 to (V+)-1.5V	25°C	95	120		dB
			全温	90			
输出参数							
A _{OL}	开环电压增益	R _L =10KΩ V _o =(V-)+0.4V to (V+)-0.4V	25°C	100	130		dB
			全温	90			
V _{OH}	输出距轨电压	V _S =±16V, R _L =10KΩ	25°C	15.80			V
V _{OL}			25°C			-15.70	
I _{SC}	输出短路电流 ^{(6) (7)}	V _S =±2.5V, V _o =0V	25°C	15	20		mA
		V _S =±16V, V _o =0V		60	80		
R _o	开环输出阻抗 ⁽⁴⁾	f=1MH, I _o =0mA			120		Ω
C _{LOAD}	容性负载驱动能力 ⁽⁴⁾				1		nF
频率响应参数							
SR	压摆率 ⁽⁸⁾	V _S =±2.5V, G=+1, C _L =100pF	25°C		1.0		V/μs
GBW	增益带宽积	V _S =±2.5V	25°C		2.0		MHz
t _s	建立时间, 0.1%	V _S =±2.5V, G=+1, C _L =100pF, Step=2V	25°C		6.6		μs
t _{OR}	过载恢复时间	V _{IN} ·Gain≥V _S , G=-10	25°C		1.6		μs

噪声参数

En	输入电压噪声	$f = 0.1\text{Hz to } 10\text{Hz}, V_S = \pm 2.5\text{V}$	25°C		0.6		μVpp
en	输入电压噪声密度 ⁽⁴⁾	$f = 1\text{KHz}$	25°C		30		$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
		$f = 10\text{KHz}$			14		

注意：

- (1) 该表仅代表指定温度下及工厂测试条件下的产品参数。工厂测试条件下，产品的自热非常有限。
- (2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制（SQC）方法的相关性来确保工作温度范围的限制。
- (3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。
- (4) 该参数由设计和/或特性保证，不需要在生产中进行测试。
- (5) 正电流对应流入产品的电流。
- (6) 最大功耗是有关 $T_{J(\text{MAX})}$ 、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_{J(\text{MAX})} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。
- (7) 短路实验是瞬时实验。
- (8) 取值为正负转换速率中较慢的值。
- (9) 保证全温度范围。

7.5 典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (除非特别注明)。

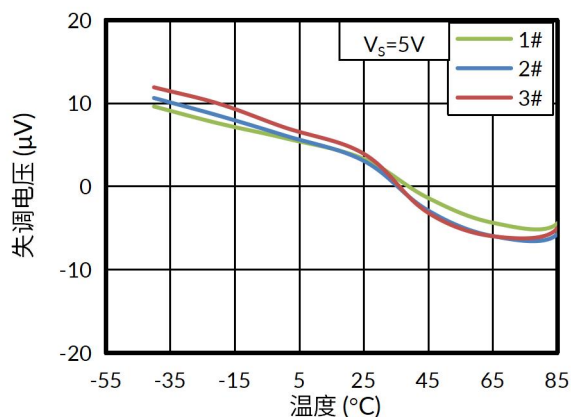


图 1. 失调电压与温度的关系

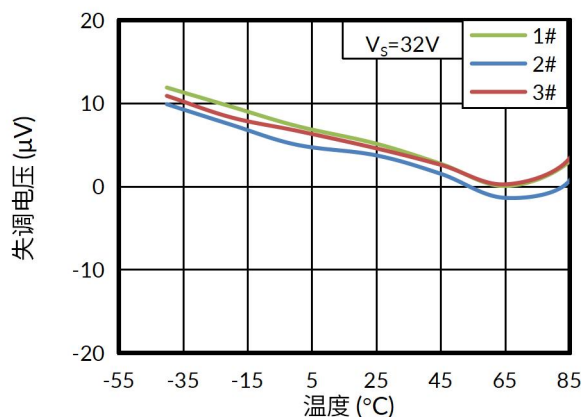


图 2. 失调电压与温度的关系

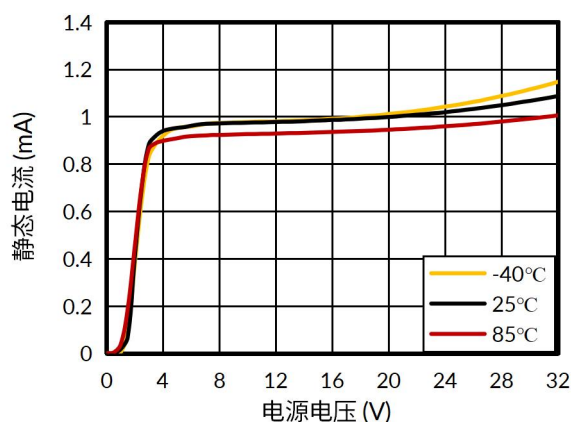


图 3. 静态电流与电源电压的关系

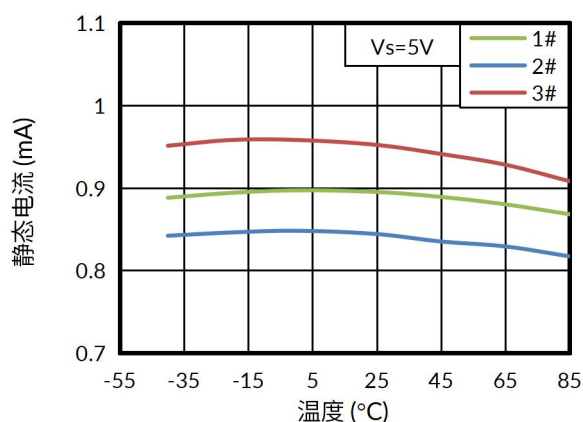


图 4. 静态电流与温度的关系

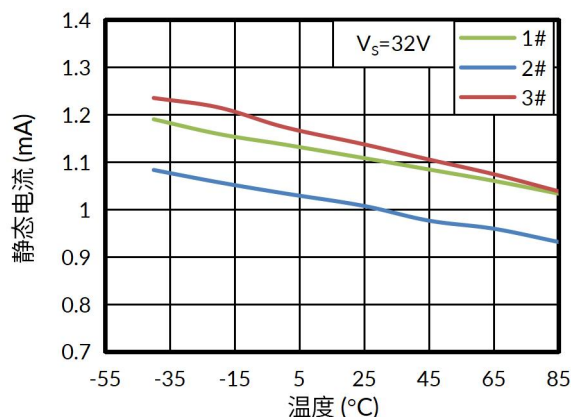


图 5. 静态电流与温度的关系

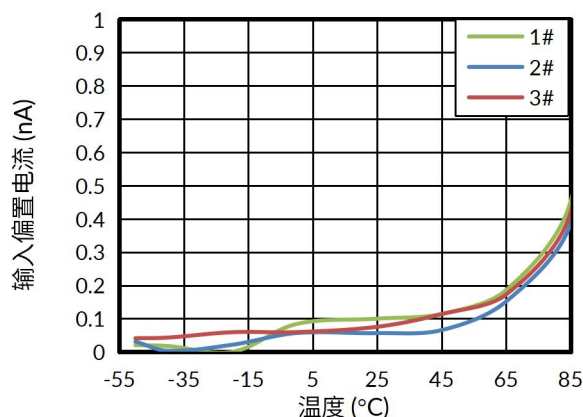


图 6. 输入偏置电流与温度的关系

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (除非特别注明)。

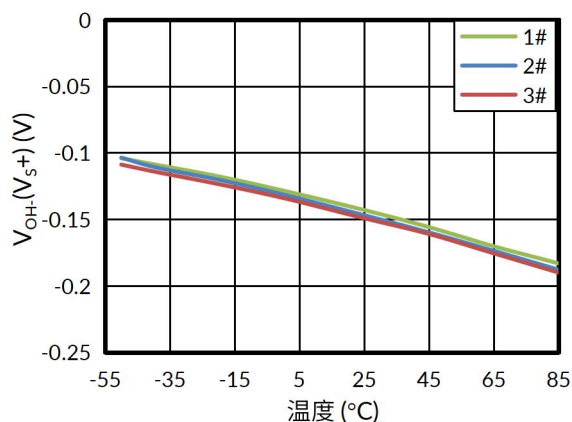


图 7. 输出距轨电压与温度的关系

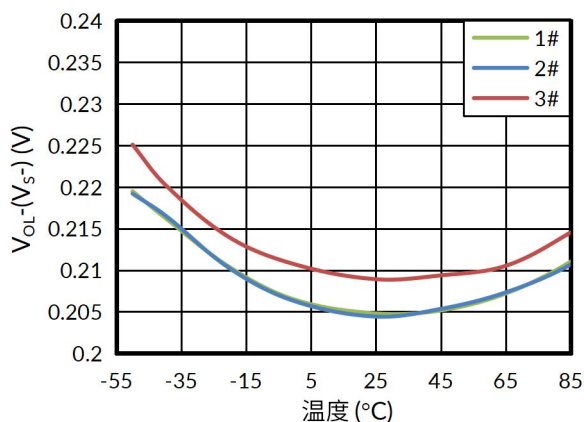


图 8. 输出距轨电压与温度的关系

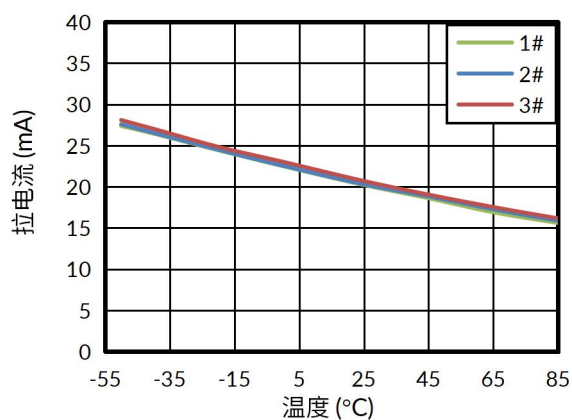


图 9. 拉电流与温度的关系

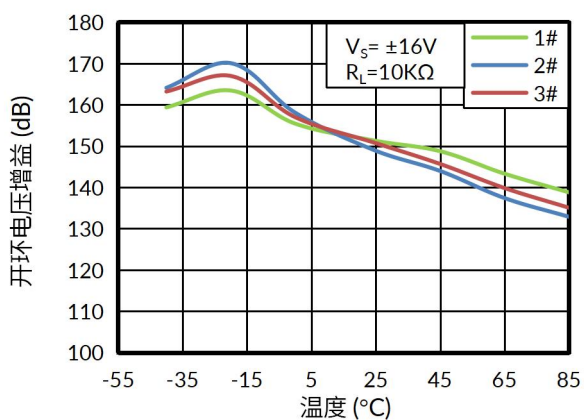


图 10. 开环电压增益与温度的关系

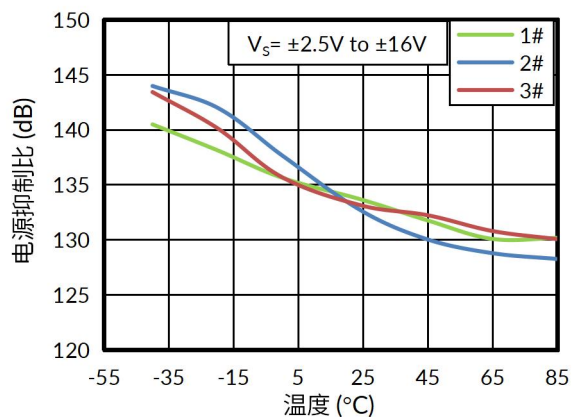


图 11. 电源抑制比与温度的关系

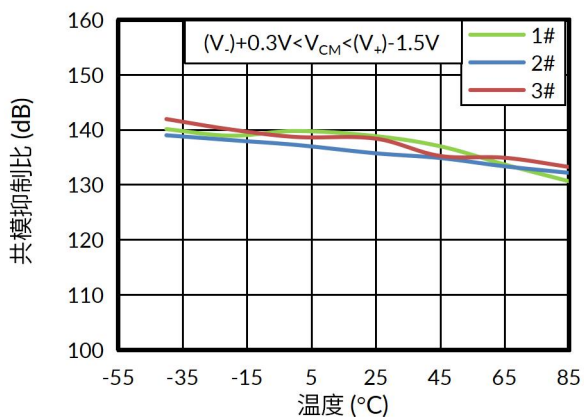


图 12. 共模抑制比与温度的关系

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (除非特别注明)。

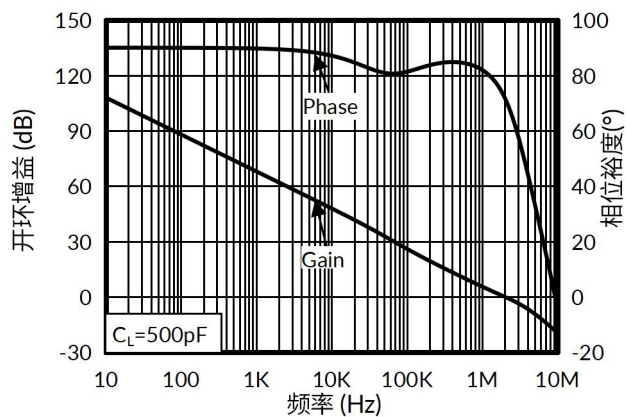
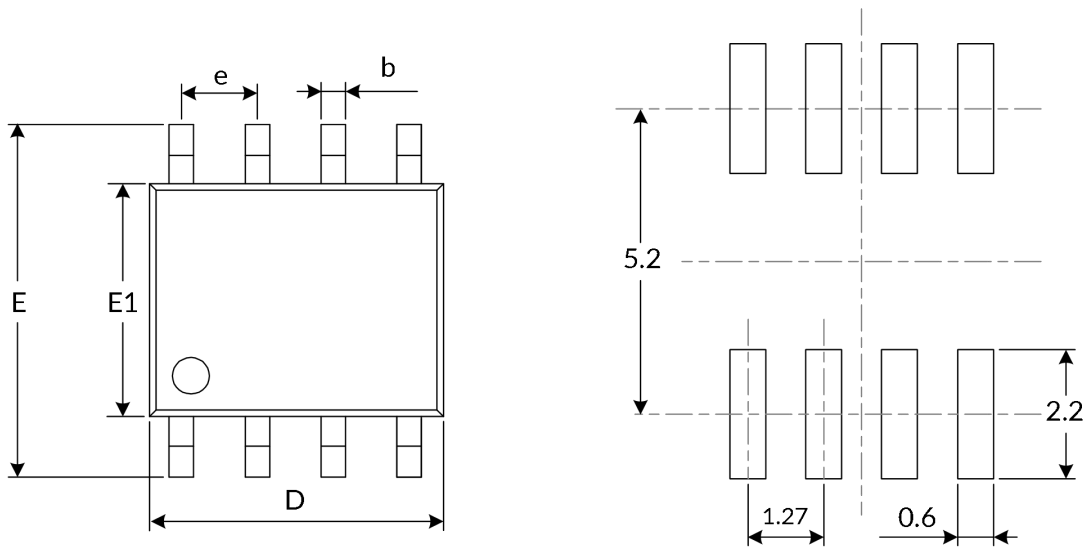
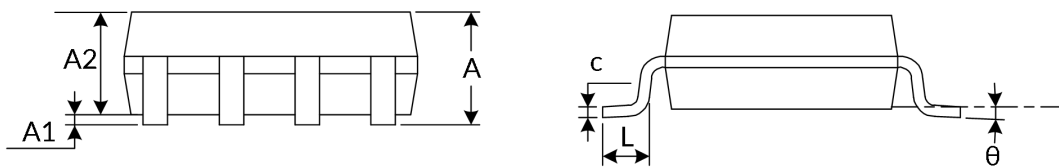


图 13. 开环增益和相位裕度与频率的关系

8 封装规格尺寸

SOP8⁽³⁾

推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)



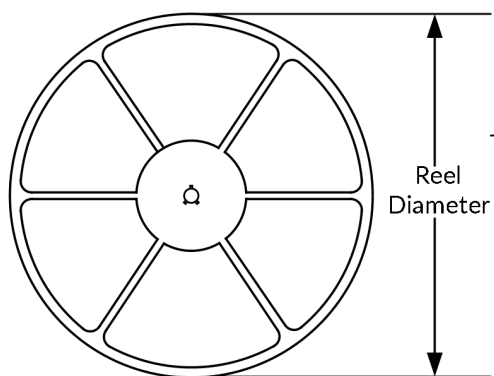
符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D ⁽¹⁾	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

注意:

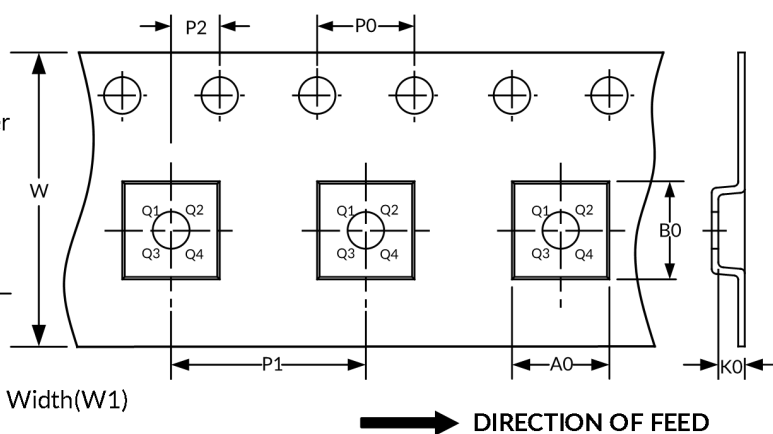
1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

9 包装规格尺寸

卷盘尺寸



编带尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOP8	13"	12.4	6.4	5.4	2.1	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

注意：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。